

Lasertec

個人投資家向け会社説明会

2026年6月24日

レーザーテック株式会社

東証プライム上場

証券コード：6920

目次

1. 半導体チップとレーザーテック
2. レーザーテックの強みと役割
3. 業績見通しと今後の成長戦略

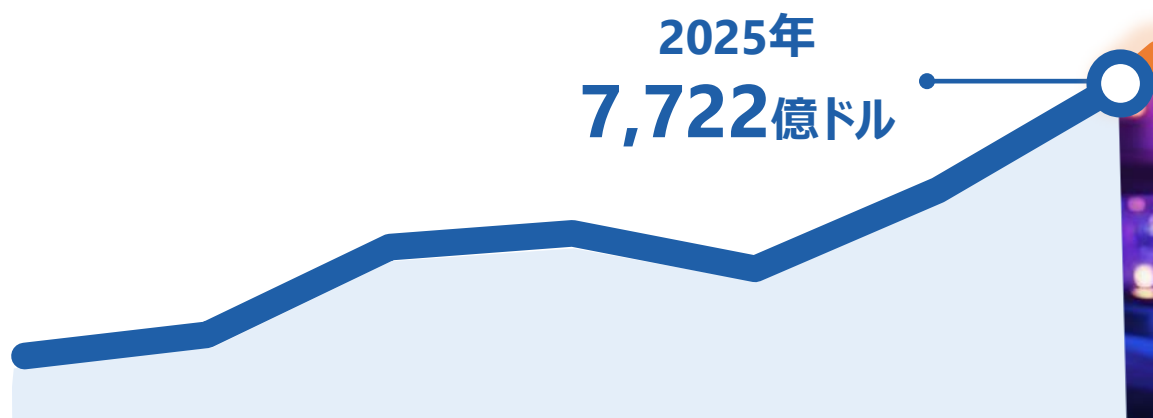
目次

1. 半導体チップとレーザーテック
2. レーザーテックの強みと役割
3. 業績見通しと今後の成長戦略

半導体市場の展望

市場の牽引役は「AI」

- ハイパースケーラーの巨額投資が流入
- CPU・GPU・DRAM・HBMなど半導体需要が拡大



Source: WSTS Semiconductor Market Forecast Spring, June 2026

版画と半導体の共通点「積層される技術」

半導体づくり
チップができる

①
回路の設計



②
原版の描画



③
遮光膜の形成



④
回路の形成

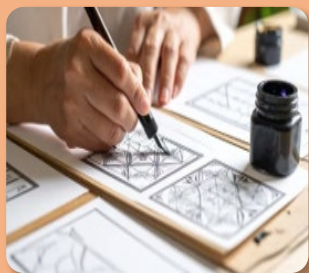


⑤
チップの完成

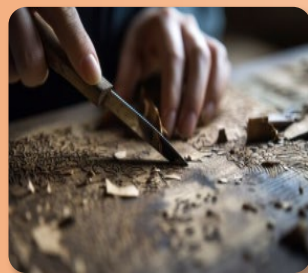


日本の伝統
「版画」
作品ができる

①
絵の設計



②
版の彫刻



③
版へのインク塗り



④
絵柄の形成



⑤
版画の完成



1枚の原版から大量に複製する点で、日本の伝統「版画」と類似
原版にわずかなキズがあるだけで、多くの不良品が生まれてしまう

半導体の回路ができるまで

マスクブランクスメーカー

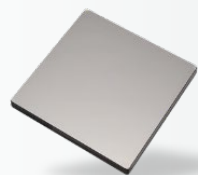
HOYA / AGC / 信越化学

マスクショップ（原版製造）

TSMC / Samsung / Intel
SK hynix

ファブ（デバイス製造）

TSMC / Samsung / Intel
SK hynix / キオクシア



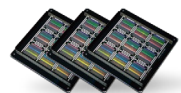
マスクブランク

ガラス基板を遮光膜で覆った
『原版の土台』

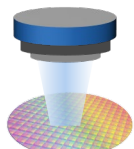
版木



半導体の露光工程



多数のフォトマスクを
使用し、



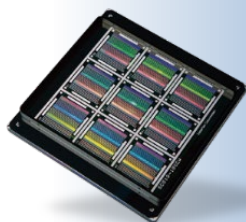
回路パターンを縮小して
ウエハに転写する露光を
繰り返し、



回路パターンを
何層にも積み重ねる

DUV露光のイメージ図

フォトマスク

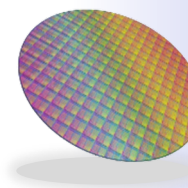


マスクブランクに微細な回路
パターンを形成した『原版』

版



露光



ウエハ

Si結晶の円形基板
露光で回路形成

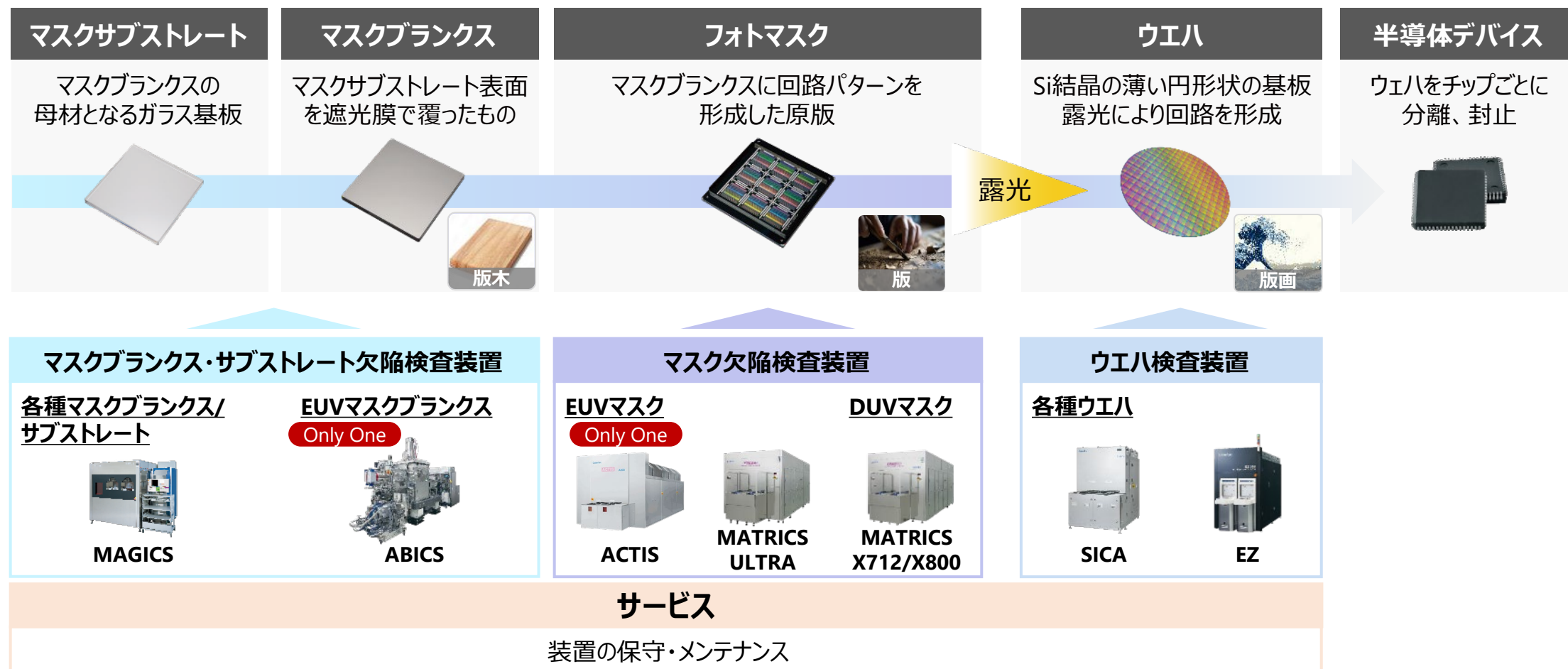
版画（完成品）



半導体デバイス製造を支える検査ソリューション

半導体デバイスは、半導体回路の原板となる「マスク」を用いて製造されています。
レーザーテックは主に、「フォトマスク」とその基板となる「マスクブランク」などを光で検査します。

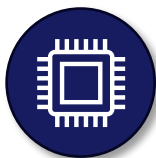
主な検査対象



わずかな傷でも、巨額の損失を生む



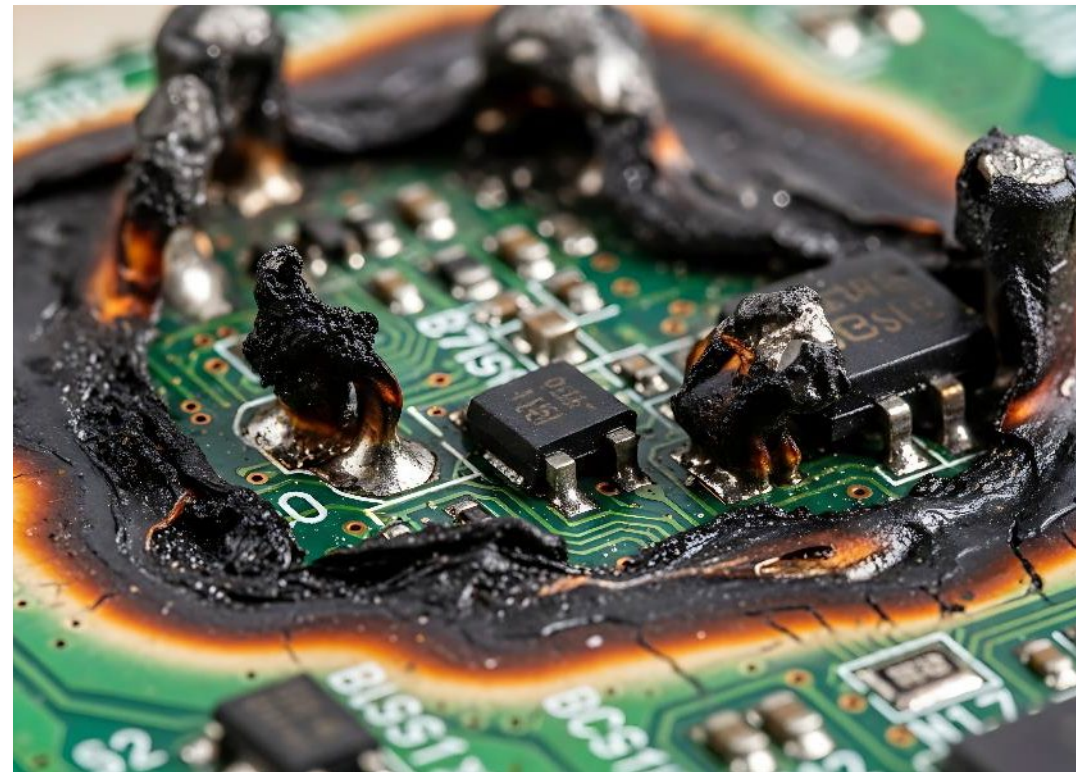
原版（フォトマスク）に欠陥があると
露光工程で欠陥を転写



何万枚ものチップが不良品になる
製造コストに大きく波及



ファブ（半導体製造工場）にとって
巨額の損失を生む
生産性・納期・信頼性に影響を及ぼす



原版の欠陥を正確に見つけ出す検査装置が不可欠

検出するフォトリソマスクの欠陥の大きさ

山手線



1円玉とのサイズ比較



直径
20mm

厚さ
1.5mm

1円玉の直径に対して
数百万分の1以下

微細化に伴い、**高感度な検査**が必要

EUV光を用いた検査が
不可欠

アクティニック技術を用いた唯一の検査技術

- 露光波長と同じEUV光（13.5nm）を用いた検査方式を採用
- DUV光（193nm）と比較し、高い欠陥検出感度を実現
- EUVマスク特有の転写性位相欠陥も検出可能

100%

Lasertec Share



ABICS
EUVマスクブランク欠陥検査/
レビュー装置



ACTIS
EUVパターンマスク欠陥検査装置

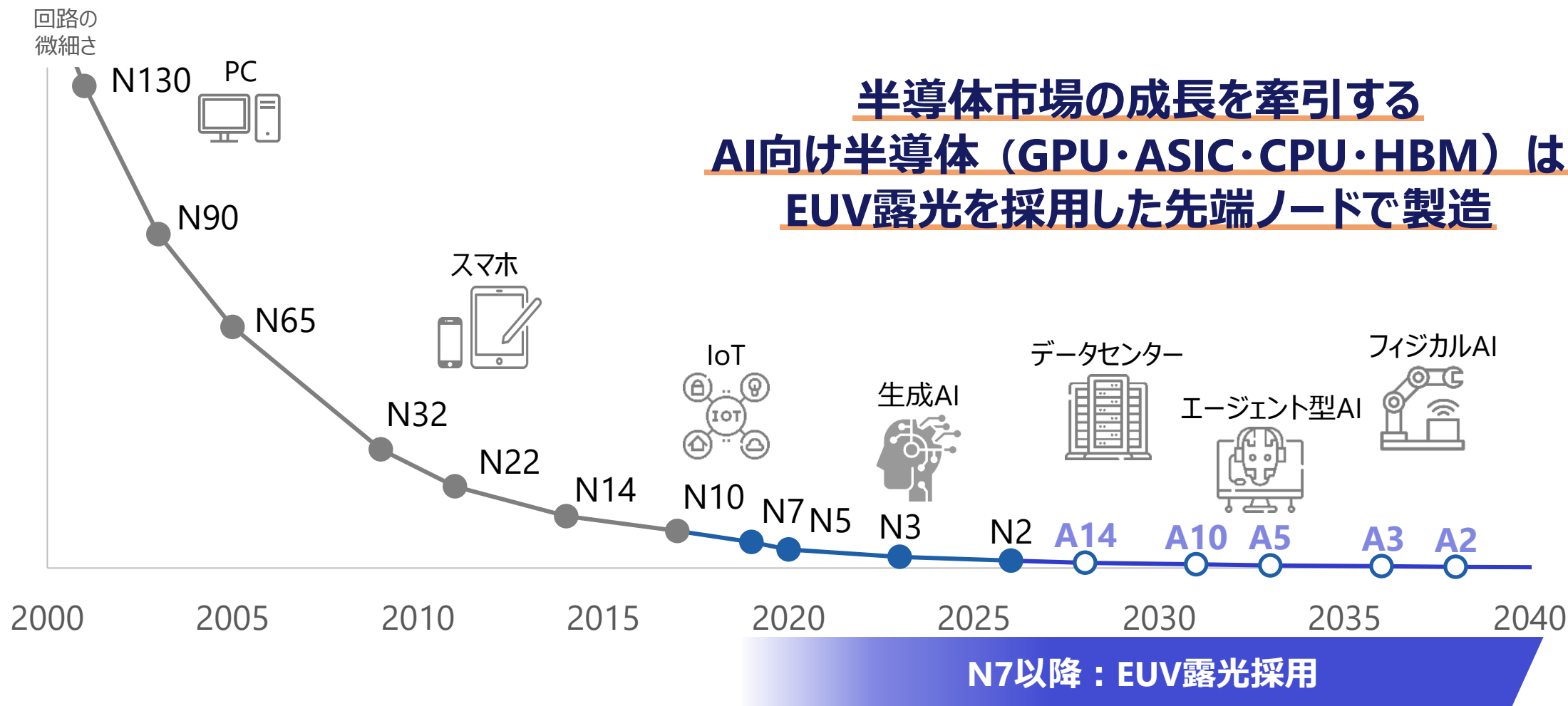
微細化はオングストローム世代へ

ナノメートル世代

1nmは10億分の1m (DNAは2nm)

オングストローム世代

1nmは100億分の1m (原子は1Å)



Source: Imec roadmap, May 2026

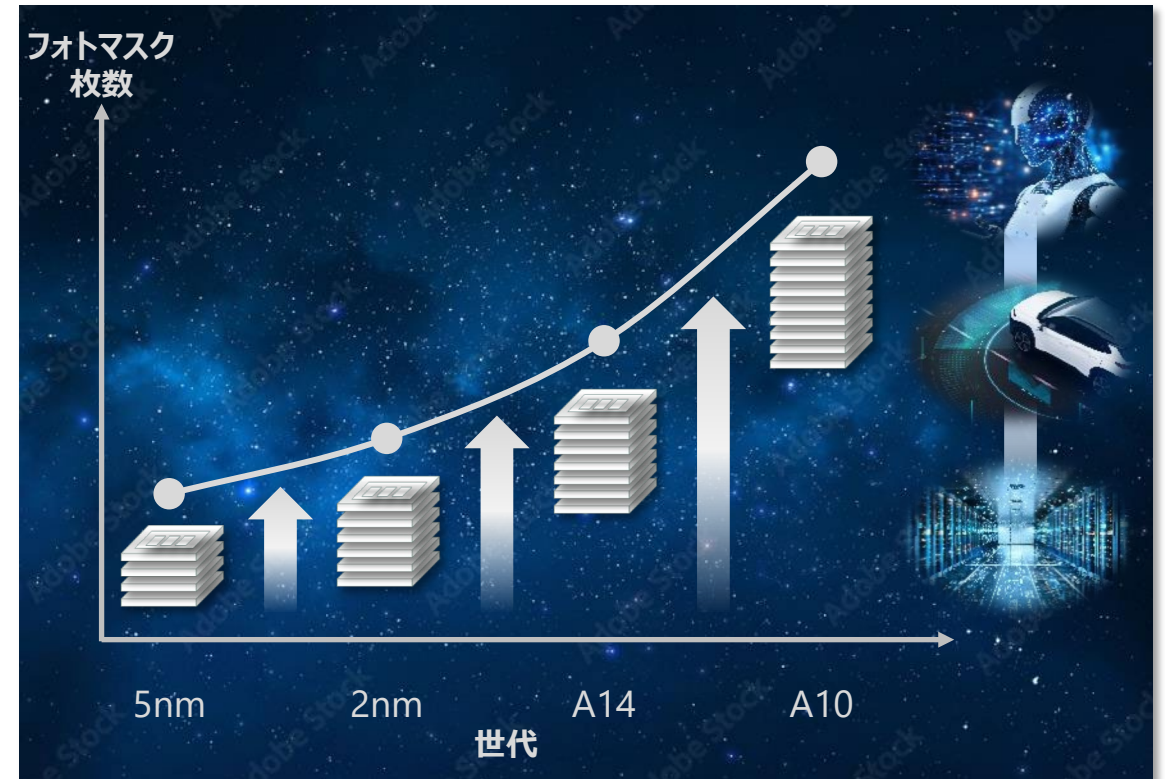
微細化が進むほど、当社の活躍の場は飛躍的に増えていく



世代が進むにつれて製造難度の
高いフォトマスクの枚数が増加



EUV光を用いた検査ニーズの増加



微細化に伴う検査ニーズの増加が成長ドライバー

目次

1. 半導体チップとレーザーテック
2. レーザーテックの強みと役割
3. 業績見通しと今後の成長戦略

レーザーテックとは

経営理念

世の中にないものをつくり、
世の中のためになるものをつくる

ビジョン

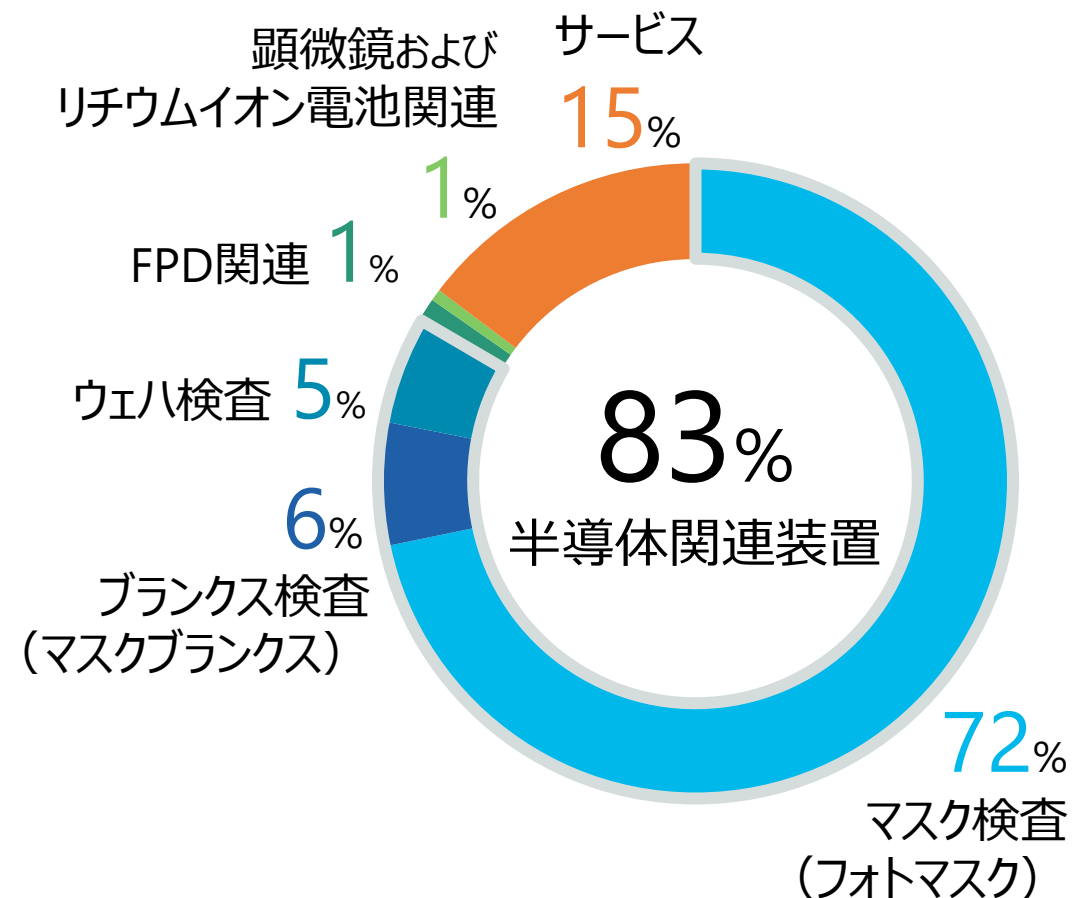
世界中のお客さまから
真っ先に声をかけていただける会社

ミッション

光技術の分野でどこよりも早くソリューションを
提供し、お客さまの問題解決に貢献する

製品別 売上構成比

3期の平均 FY2023-2025



検査・計測ソリューションを支えるコア技術と経営戦略

光応用技術をコア技術として画期的な製品を生み出し、さまざまなお客さまのニーズにお応えしています。



レーザーテックの経営戦略

- 1 スピード決定・開発・対応
- 2 グローバルニッチトップ
- 3 ファブライト

1 スピード決定・開発・対応

- 素早い意思決定、迅速な行動と最速の製品開発を実現するフラットで柔軟な組織
- お客様のニーズに対して、いち早くソリューションを提供

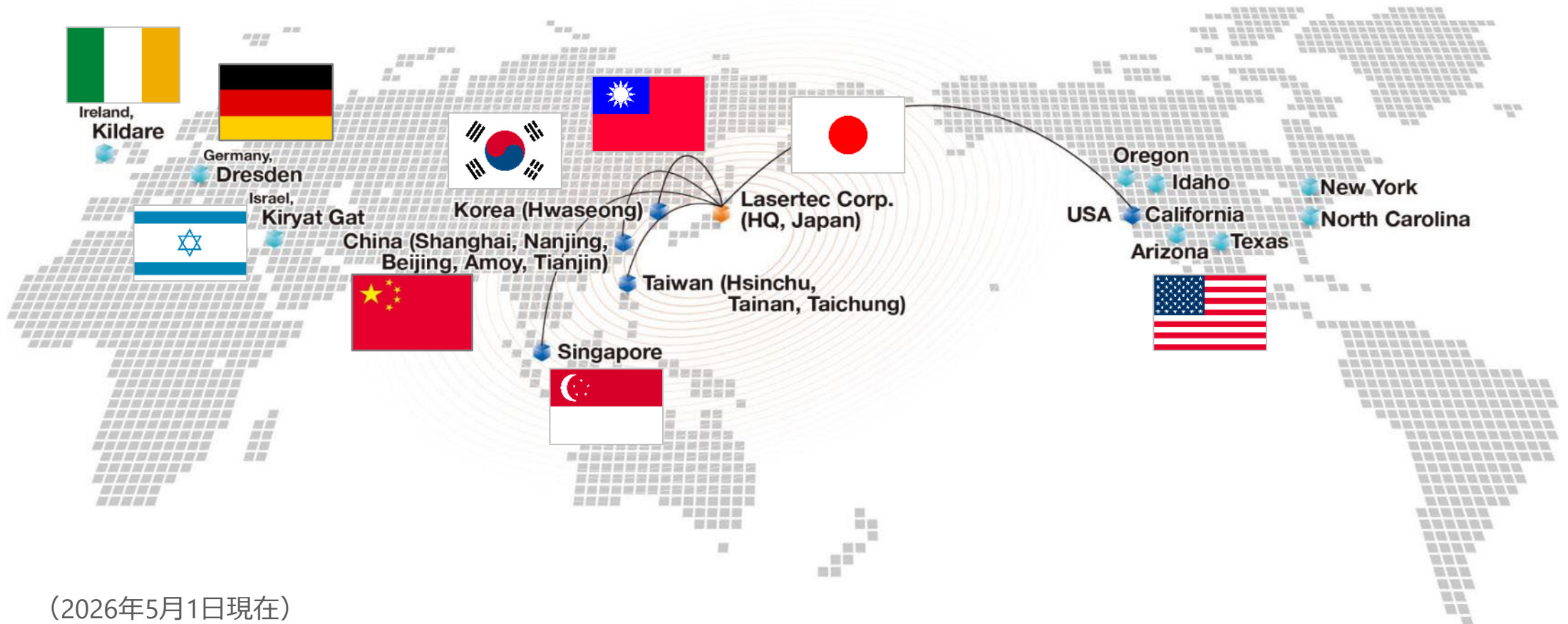
2 グローバルニッチトップ

- 高い技術力と付加価値で差別化できる市場で、高シェアと高収益を追求
- 世界的なリーダー企業との強固な信頼関係と緊密な情報共有でビジネスチャンスを最大化
(FY2025 海外売上比率：91.8%)

3 ファブライト

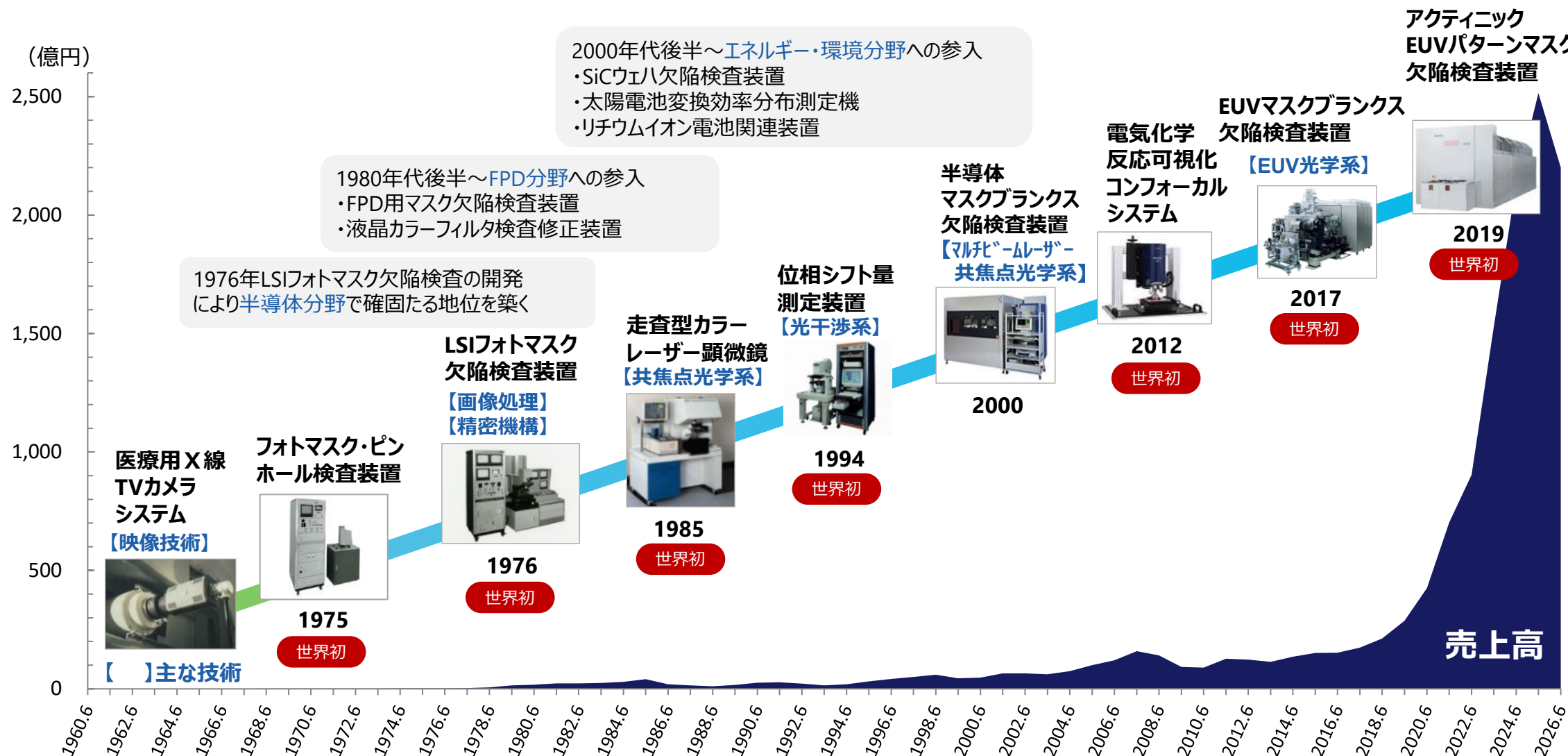
- エンジニアは研究開発とお客様対応に特化 (FY2025 エンジニア比率：約70%)
- 生産を外部委託し、アセットライトで機動的な事業体制を構築

世界9つの国・地域28拠点

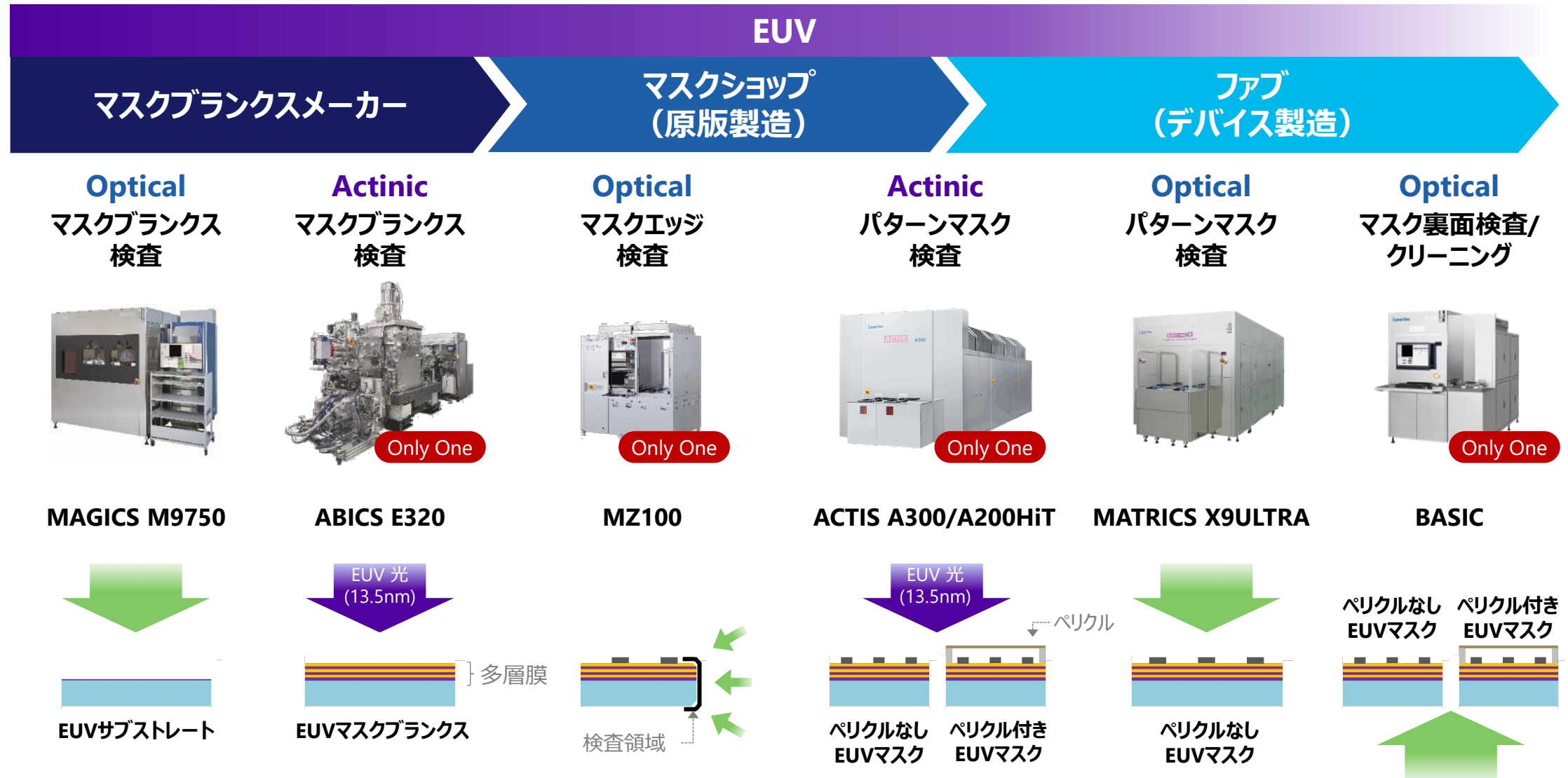


世界ではじめての製品

1960年の創業以来、世界初となる画期的な製品を数多く生み出してまいりました。



EUV関連装置のラインナップ



サステナビリティ経営の考え方

経営理念の具現化を追求することで、サプライヤーの皆さまやお客さまと協働しながら、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献し、中長期的な企業価値向上とサステナブルな社会の実現に寄与するよう努めてまいります。

マテリアリティ			要素
事業活動	開発・製造	1  経済・社会価値を生み出す製品開発力	- 新規事業の開発 - イノベーションを生み出す開発・製造体制 - 環境に配慮した製品の実現
	販売・サービス	2  顧客ニーズを迅速に実現する対応力	- 既存ビジネスでのシェア確保 - 顕在的・潜在的な顧客ニーズの把握 - 顧客の安心を維持するグローバルサポート体制
	調達	3  持続可能なサプライチェーン	- ファブライトを実現するサプライヤーの確保 - 持続可能な原材料調達 - サプライヤーの人権・環境問題の把握と改善
経営基盤		4  人材を活かす組織体制・風土	- 研究・開発をささえる人材の育成・確保 - フラットで柔軟な組織風土 - 従業員の健康と安全、多様性・人権への配慮
		5  持続可能性に配慮したガバナンス体制	- 製造におけるエネルギーマネジメント - ESGリスクの抽出・モニタリング・開示 - リスクマネジメント・コンプライアンス

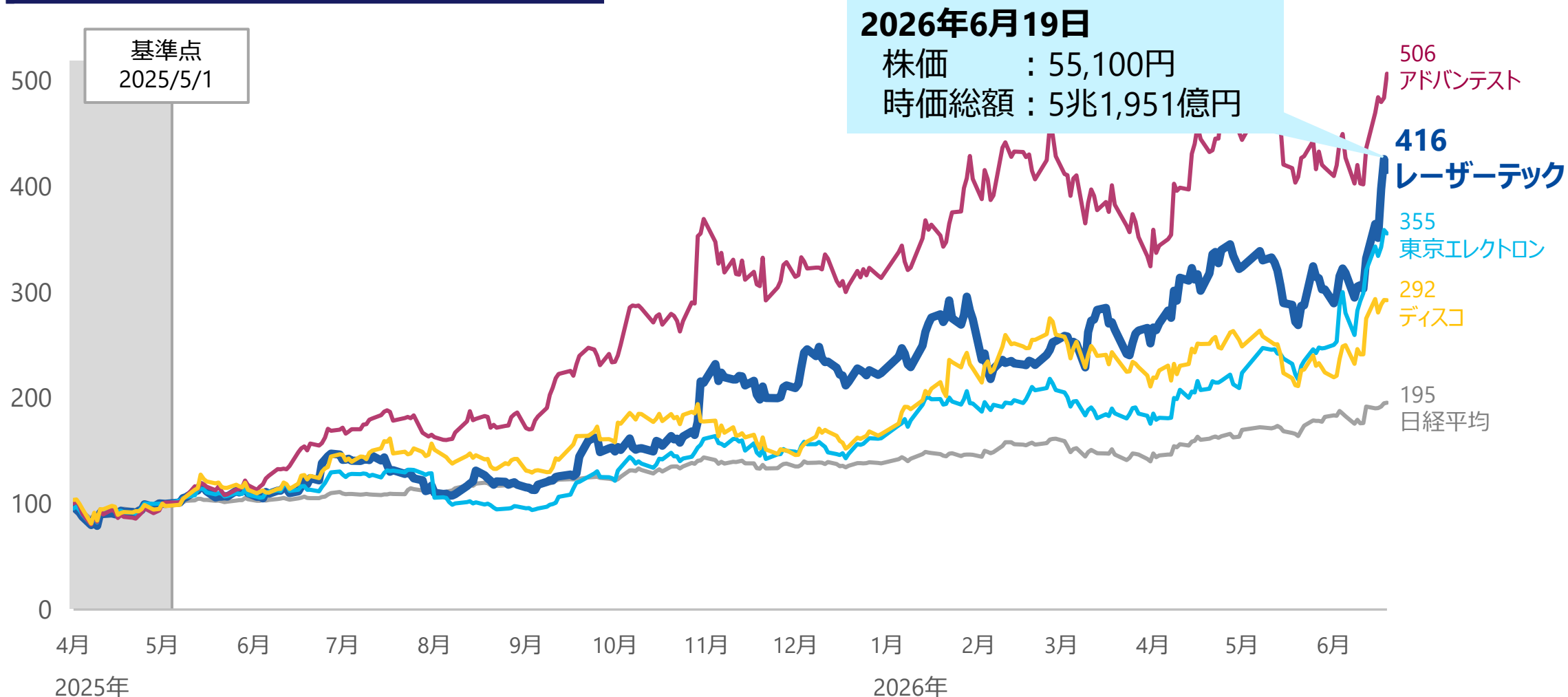
目次

1. 半導体チップとレーザーテック
2. レーザーテックの強みと役割
3. 業績見通しと今後の成長戦略

株価推移（同業他社比）

株価推移（2025/4/1～2026/6/19）

※2025/5/1を100とした指数表記



Source: Investing.com HP

*1. 2026年6月19日時点 *2. 時価総額 = 株価 × 発行済株式総数（自己株式含む）

2026年6月期 通期業績予想

(百万円)

	FY2024	FY2025	FY2026 予想	前年度比 増減率
売上高	213,506	251,477	220,000	▲ 12.5%
半導体	181,752	202,965	165,000	▲ 18.7%
その他	2,783	5,552	3,500	▲ 37.0%
サービス	28,970	42,959	51,500	+ 19.9%
営業利益	81,375	122,843	100,000	▲ 18.6%
営業利益率	38.1%	48.8%	45.5%	-
当期純利益	59,076	84,652	72,000	▲ 14.9%
研究開発費	12,165	11,677	13,000	+ 11.3%
売上高研究開発費比率	5.7%	4.6%	5.9%	-
設備投資額	2,533	5,037	2,700	▲ 46.4%
減価償却費	4,726	4,676	4,300	▲ 8.1%
(円)				
1株当たり配当金	230	329	329	-
配当性向	35.1%	35.1%	41.0%	-

*想定為替レート：155円/米ドル

中期経営計画（2025年6月期－2030年6月期）

方針 | 圧倒的な開発スピード、高い技術力、顧客との強固な信頼関係の構築により
売上最大化とさらなる成長を目指す

売上最大化へ向けたブラッシュアップ

リードタイムの短縮

さらなる市場拡大を見据えたリードタイムの短縮

現状

今後

1.5年~2年 ⇒ **0.5年~1.5年**

サービスビジネスの拡大

お客さまに安心して装置をご使用いただけるサポートを提供

現状

今後

約10% ⇒ **>20%**

さらなる成長へ向けた研究開発の推進と体制づくり

人材採用の強化と職場環境の整備

社員が力を存分に発揮できる環境整備

グループ従業員数
毎年 >200名増

新たなソリューションによる事業領域の拡大

成長を見据えたニーズの探索

さらなる成長に向けた
“種まき”への積極投資

事業規模拡大を支える体制の強化

事業規模拡大を支える体制強化

グローバル連携の強化による
間接部門の**体制強化**

財務目標（～2030年6月期）

売上高

4,000～5,000 億円

営業利益率

> 35%

*財務目標値の前提

想定為替レート：140円 / 米ドル

売上高研究開発費比率：10%

Lasertec